

■巻頭言ー新しい実装技術のイノベーションを目指して／NEC特許技術情報センター 嶋田勇三	
■平成23年表彰	241
■特集／電子機器の最新EMC技術	
特集に寄せて／三菱電機 岡 尚人	247
静電気放電の基礎／名古屋工業大学 藤原 修	248
ESDガンの等価回路モデルの改良 (IEC61000-4-2 Ed.2.0対応)	
／ルネサスエレクトロニクス 秋山雪治, ノイズ研究所 戸澤幸大, 石田武志	254
電子回路の内部動作に同期したイミュニティ測定／日本電気 塚越常雄	262
シールド付きツイストペアケーブルのノイズ耐性評価	
／三菱電機 渡邊陽介, 佐々木雄一, 宮崎千春, 岡 尚人, 三須幸一郎	267
コンデンサ内蔵インタポーザを適用したシステムLSIのイミュニティ評価	
／パナソニック 高橋英治, 齊藤義行, 佐々木智江, 井ノ上大輔	272
電子機器のイミュニティシミュレーション／デンソー 市川浩司	278
スイッチング電源のノイズ解析／日本アイ・ビー・エム 高橋成正, ライズコーポレーション 桐畑美耶, 柳田 進	282
■研究論文	
修正累積損傷モデルによるSn-Ag-Cu系BGAはんだ接合部の断線寿命予測	
／日立製作所 寺崎 健, 谷江尚史, 日立金属 千綿伸彦, 若野基樹, 藤吉 優	287
電子部品の耐食性に及ぼす下地Niめっきの影響／第一電子工業・宇都宮大学 田所義浩, 栃木県産業技術センター 竹澤信隆, 伊藤繁則, 宇都宮大学 佐藤正秀, 古澤 毅, 鈴木 昇	296
■講座 TSV基礎講座 ②	
TSVの形成技術(1)イオンエッチングとビア内壁膜作成／長野県工科短期大学校 傳田精一	305
■研究室訪問	
中京大学情報理工学部情報システム工学科磯研究室／中京大学 磯 直行	311
第16回通常総会報告	312
入会者紹介	335
編集後記	336
会告	①~④

投稿論文募集中

「エレクトロニクス実装学会誌」では、投稿論文を受け付けております。詳しくはVol. 14 No. 2 (2011年3月号) 151~156ページ掲載の「投稿規程」「査読について」「原稿執筆の手引き」をご覧ください。また、論文投稿に関して問い合わせ等ございましたら、Eメール (hensyu@jiep.or.jp) までご連絡ください。

■Preface – Toward the Innovation of the New Packaging Technology / Yuzo SHIMADA	
■2011 JIEP Award	241
■Special Articles / Latest EMC Technology of Electronic Equipment	
Intention to the Special Edition / Naoto OKA	247
Fundamental of Electrostatic Discharge / Osamu FUJIWARA	248
Improvement of the Equivalent Circuit Modeling for an ESD-Gun (Based on IEC61000-4-2 Ed.2.0) / Yukiharu AKIYAMA, Yukihiko TOZAWA, and Takeshi ISHIDA	254
Immunity Measurement Synchronized with Internal Operation of LSI / Tsuneo TSUKAGOSHI	262
Noise Immunity of Twisted Pair Cable with Shielded Sheath / Yosuke WATANABE, Yuichi SASAKI, Chiharu MIYAZAKI, Naoto OKA, and Koichiro MISU	267
Immunity Evaluation of an LSI Mounted on an Interposer with Embedding Capacitors / Eiji TAKAHASHI, Yoshiyuki SAITO, Chie SASAKI, and Daisuke INOUE	272
Immunity Simulation for Electronics Equipment / Kouji ICHIKAWA	278
Modeling Analysis for Switching Voltage Regulator / Narimasa TAKAHASHI, Miya KIRIHATA, and Susumu YANAGITA	282
■Technical Papers	
Use of Modified Accumulated Damage Model to Predict Fatigue Failure-life of Sn–Ag–Cu Based Solder Joints in Ball-Grid-Array-Type Packages / Takeshi TERASAKI, Hisashi TANIE, Nobuhiko CHIWATA, Motoki WAKANO, and Masaru FUJIYOSHI	287
Influence of Nickel Undercoat on Corrosion Resistance for Electronic Parts / Yoshihiro TADOKORO, Nobutaka TAKEZAWA, Shigenori ITO, Masahide SATO, Takeshi FURUSAWA, and Noboru SUZUKI	296
■Tutorial Series – The Basic Concept, Standard Structures and Fabrication Technologies of Through Silicon Vias ②	
TSV Fabrication Technology—(1) Ion Etching of Silicon and Inner Via Film Formation / Sei-ichi DENDA	305
■Report – Iso Laboratory, School of Information Science and Technology, Chukyo University / Naoyuki ISO	311
The 16th General Meeting	312
News	335
Announcement	①~④

■会 長 嶋田 勇三 ■副会長 越地 耕二 若林 信一

■編集委員会 委員長・安東 泰博 副委員長・高橋 康夫 末松 憲治 平 洋一

委員 (五十音順)・赤星 晴夫 安食 弘二 伊藤 寿浩 碓氷 光男 榎 学 海老原理徳
折井 靖光 越地 耕二 小林 一治 澤田 廉士 白石 洋一 高原 秀行
塚田 裕 塚本 健人 箕輪 俊夫 山中 公博